

TN900

5G Sub-6 Embedded Module Brief Specification Sheet



5G SA / NSA

Qualcomm SDX62

NR 2.0 Gbps

eSIM · FOTA

Product Overview

TELADIN TN900은 Qualcomm SDX62 칩셋을 적용한 5G SA/NSA 듀얼 모드 임베디드 모듈입니다. Sub-6 대역에서 최대 2.0 Gbps의 초고속 다운로드를 제공하며, eSIM·FOTA·MultipleAPN 등 차세대 기능을 폭넓게 지원하는 M.2 표준 폼팩터 모듈입니다.

Key Features

5G SA / NSA Dual Mode

Qualcomm SDX62를 채택하여 5G Standalone(SA) 및 Non-Standalone(NSA) 모드를 완벽히 지원합니다.

Ultra-fast Throughput

국내 5G Sub-6 전 대역(n1부터 n78까지)에서 NR 2 Gbps DL / 200 Mbps UL의 초고속 전송을 제공합니다.

Global GNSS

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou를 모두 수용하는 측위 하드웨어를 내장하여 무인 이동체, 자율주행 AGV의 실시간 위치 트래킹 및 정밀 제어 시스템 구축을 돕습니다

Carrier-grade Features

eSIM·FOTA·MultipleAPN 등 통신사급 기능을 제공합니다.

Technical Specifications

구분 (Specifications)	TN900
Target Market / Network	Korea (KT / LG U+ / SKT)
Category	5G Embedded Module
Operation Mode	5G SA / NSA Dual Mode
Baseband Chipset	Qualcomm SDX62
Frequency Bands	5G Sub-6 n77/n78/n79
Data Rates (NR)	NR 2 Gbps DL / 200 Mbps UL
LTE Rates	1.5 Gbps DL / 200 Mbps UL
OS Support	Linux
Key Features	eSIM / FOTA / Multiple APN / SIM Lock / VoLTE
Hardware Interfaces	USB 3.1/2.0 / GPIO / UIM / I2S / MIPI
Connector	75-pin M.2 / Main-Div + 4 Ant.
Power Supply	3.135~4.4 V (Typ. 3.8 V)
Operating Temp.	-20 to +60 °C (확장 -30 to +80 °C)
Physical Dimensions	30 × 52 × 2.3 mm